



平成30年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕（連結）

平成29年11月9日

上場会社名 シンデン・ハイテックス株式会社 上場取引所 東
 コード番号 3131 URL http://www.shinden.co.jp/
 代表者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 鈴木 淳
 問合せ先責任者 (役職名) 専務取締役 (氏名) 齋藤 敏積 TEL 03-3537-0101
 四半期報告書提出予定日 平成29年11月9日 配当支払開始予定日 —
 四半期決算補足説明資料作成の有無：無
 四半期決算説明会開催の有無：無

(百万円未満切捨て)

1. 平成30年3月期第2四半期の連結業績（平成29年4月1日～平成29年9月30日）

(1) 連結経営成績（累計） (%表示は、対前年同四半期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		親会社株主に帰属する 四半期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
30年3月期第2四半期	26,491	25.0	839	—	736	—	502	—
29年3月期第2四半期	21,186	△18.6	△170	—	△412	—	△272	—

(注) 包括利益 30年3月期第2四半期 495百万円 (—%) 29年3月期第2四半期 △324百万円 (—%)

	1株当たり 四半期純利益	潜在株式調整後 1株当たり 四半期純利益
	円 銭	円 銭
30年3月期第2四半期	312.99	309.98
29年3月期第2四半期	△161.47	—

(注) 平成29年3月期第2四半期の潜在株式調整後1株当たり四半期純利益については、潜在株式は存在するものの、1株当たり四半期純損失であるため記載しておりません。

(2) 連結財政状態

	総資産	純資産	自己資本比率	1株当たり純資産
	百万円	百万円	%	円 銭
30年3月期第2四半期	25,570	3,803	14.8	2,344.78
29年3月期	21,206	3,403	16.0	2,129.72

(参考) 自己資本 30年3月期第2四半期 3,795百万円 29年3月期 3,395百万円

2. 配当の状況

	年間配当金				
	第1四半期末	第2四半期末	第3四半期末	期末	合計
	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭
29年3月期	—	0.00	—	90.00	90.00
30年3月期	—	0.00	—	—	—
30年3月期(予想)	—	—	—	110.00	110.00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無：無

3. 平成30年3月期の連結業績予想（平成29年4月1日～平成30年3月31日）

(%表示は、対前期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		親会社株主に帰属 する当期純利益		1株当たり 当期純利益
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%	円 銭
通期	51,200	15.2	1,250	49.1	1,050	109.0	700	93.2	434.23

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無：無

※ 注記事項

(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）：無

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用：無

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

- ① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 : 無
- ② ①以外の会計方針の変更 : 無
- ③ 会計上の見積りの変更 : 無
- ④ 修正再表示 : 無

(4) 発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む）	30年3月期2Q	1,841,200株	29年3月期	1,841,200株
② 期末自己株式数	30年3月期2Q	222,600株	29年3月期	246,800株
③ 期中平均株式数（四半期累計）	30年3月期2Q	1,605,525株	29年3月期2Q	1,686,098株

※ 四半期決算短信は四半期レビューの対象外です

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、実際の業績等は、様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、添付資料P.3「1. 当四半期決算に関する定性的情報（3）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明」をご覧ください。

1株当たり当期純利益につきましては、期中平均株式数の変動を考慮して算定しております。

○添付資料の目次

1. 当四半期決算に関する定性的情報	2
(1) 経営成績に関する説明	2
(2) 財政状態に関する説明	2
(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明	3
2. 四半期連結財務諸表及び主な注記	4
(1) 四半期連結貸借対照表	4
(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書	5
四半期連結損益計算書	
第2四半期連結累計期間	5
四半期連結包括利益計算書	
第2四半期連結累計期間	6
(3) 四半期連結財務諸表に関する注記事項	7
(継続企業の前提に関する注記)	7
(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)	7
3. 品目別販売実績	7

1. 当四半期決算に関する定性的情報

(1) 経営成績に関する説明

当第2四半期連結累計期間における世界経済につきましては、引続き米国経済が、輸出の改善と内需拡大を背景に成長を継続しており牽引役となっております。また、欧州経済は製造業の好転につれて景気回復過程にあり、過剰生産能力の調整過程にある中国経済はインフラ投資を含めた景気刺激策で成長を維持しており、明るい材料が出てまいりました。

日本経済につきましては、世界経済が緩やかな回復に向かいつつある中で、実質GDPが持ち直すなど、雇用の改善とともに個人消費も回復に転じており、IT産業向けを中心とする輸出が堅調に推移し、欧州、米国向けに加えアジア新興国への機械・電子部品等の輸出が増加傾向にあります。

当社グループが属するエレクトロニクス業界につきましては、旺盛な半導体需要を背景に、半導体製造装置の輸出が堅調な伸びを示し、アジア新興国向けの電子部品、デバイス類の輸出や、関連する装置ビジネスも同様に推移しております。

このような情勢の下、当社グループは、引続き高採算ビジネスの営業活動に注力しており、当第2四半期連結累計期間は、半導体分野及び電子機器分野の増勢基調であるところに産業用機器向けビジネスが拡大し、業績の向上に大きく貢献しました。

当第2四半期連結累計期間の業績は、売上高は264億91百万円（前年同四半期比25.0%増）、営業利益は8億39百万円（前年同四半期は営業損失1億70百万円）、経常利益は7億36百万円（前年同四半期は経常損失4億12百万円）、親会社株主に帰属する四半期純利益は5億2百万円（前年同四半期は親会社株主に帰属する四半期純損失2億72百万円）となりました。

品目別では、液晶分野は、一部顧客の車載用機器向けがメーカ直販になったことにより、前年にくらべ減少しており、売上高96億53百万円（前年同四半期比12.3%減）となりました。半導体分野は、メモリ需要が旺盛なことと、委託開発案件ビジネスが順調に進捗し、売上高87億81百万円（前年同四半期比36.5%増）となりました。電子機器分野は、平成29年6月26日に公表しました計画外の大口受注案件と異物検出機等の装置ビジネスの堅調な推移により、売上高67億6百万円（前年同四半期比146.8%増）となりました。その他分野は、バッテリー及びその周辺機器等の新規ビジネスの立ち上がりにより売上高13億49百万円（前年同四半期比31.9%増）となりました。

セグメントの業績は、次のとおりであります。

(日本)

当第2四半期連結累計期間は、液晶分野は、一部顧客の車載用機器向けがメーカ直販になったことにより、前年にくらべ減少しました。しかしながら、半導体ブームを背景にサーバ等の情報機器向けやOA機器向けのメモリ需要が旺盛な中で、委託開発案件ビジネスも順調に推移した半導体分野や計画外の大口受注案件と異物検出機等の装置ビジネスが堅調に推移している電子機器分野、また、バッテリー及びその周辺機器等の新規ビジネスの立ち上がったその他分野が業績を牽引しました。その結果、売上高245億96百万円（前年同四半期比22.5%増）、セグメント利益は、7億88百万円（前年同四半期はセグメント損失2億10百万円）となりました。

(海外)

当第2四半期連結累計期間は、半導体ビジネス及び装置ビジネスの増加により、売上高は18億94百万円（前年同四半期比70.7%増）となり、セグメント利益は32百万円（前年同四半期比252.7%増）となりました。

(2) 財政状態に関する説明

① 資産

総資産は255億70百万円となり、前連結会計年度末に比べ43億64百万円(20.6%)増加しました。主な要因は、商品が30億49百万円(72.8%)、受取手形及び売掛金が19億84百万円(22.2%)、その他の流動資産が3億18百万円(64.2%)増加したこと、現金及び預金が10億89百万円(14.8%)減少したことによるものであります。

② 負債

負債は217億67百万円となり、前連結会計年度末に比べ39億64百万円(22.3%)増加しました。主な要因は、有利子負債が20億19百万円(17.6%)、買掛金が18億35百万円(32.2%)増加したことによるものであります。

③ 純資産

純資産は38億3百万円となり、前連結会計年度末に比べ3億99百万円(11.7%)増加しました。主な要因は、利益剰余金が3億59百万円(16.5%)増加したことによるものであります。

④ 経営指標

流動比率は有利子負債、買掛金の増加等により、前連結会計年度末に比べ6.2ポイント減少し148.9%となりました。自己資本比率は、商品の増加による総資産の増加等により、前連結会計年度末に比べ1.2ポイント減少し14.8%となりました。有利子負債対純資産比率は3.6倍となり、前連結会計年度末とほぼ同水準となりました。

(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

中国経済は、過剰生産と在庫の調整局面から脱しきれないものの政府のインフラ投資など景気刺激策により回復に向かいつつ、低成長ながらも世界の経済成長に影響をおよぼしていくものと推測され、今後、産業の近代化とインフラの整備につれて中華経済圏としての一大消費地域としての成長が見込まれます。また、欧州経済は、政治的リスクの後退とともに製造業が好転し、緩やかながらも回復の方向にあります。それに伴い、日本経済も中国をはじめとするアジア新興国向けや、米国、欧州向けの輸出の増加により好転していくことが想定されます。

エレクトロニクス業界全般としましては、目下、半導体分野におけるメモリの供給が不足している状況にありますが、当面は、着実に成長を続けることが想定されます。

当社グループは、既存のビジネスの深堀に注力することはもとより、新規ビジネスの開拓を積極的に取り組み、収益構造の強化を図ってまいります。

連結業績予想につきましては、当初の計画している案件が、概ね順調に進捗する見込であることと、平成29年6月26日に公表しました計画外の大口受注案件により、当初計画を大きく上回る見込みとなったため、平成29年10月25日に公表しました「通期業績予想の修正に関するお知らせ」のとおり当連結会計年度の連結業績予想を修正しております。

なお、連結業績予想につきましては、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は、今後様々な要因によって予想数値と異なる結果となる可能性があります。

2. 四半期連結財務諸表及び主な注記

(1) 四半期連結貸借対照表

(単位：千円)

	前連結会計年度 (平成29年3月31日)	当第2四半期連結会計期間 (平成29年9月30日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	7,366,016	6,276,840
受取手形及び売掛金	8,925,652	10,910,410
電子記録債権	960	105,053
商品	4,191,197	7,240,562
その他	495,581	813,591
貸倒引当金	△25,735	△29,630
流動資産合計	20,953,673	25,316,828
固定資産		
有形固定資産		
工具、器具及び備品(純額)	5,018	5,997
その他(純額)	6,776	7,770
有形固定資産合計	11,795	13,767
無形固定資産		
ソフトウェア	57,211	60,135
その他	1,311	1,311
無形固定資産合計	58,522	61,447
投資その他の資産		
差入保証金	174,932	176,358
その他	7,133	2,353
貸倒引当金	△5	△1
投資その他の資産合計	182,060	178,709
固定資産合計	252,378	253,925
資産合計	21,206,051	25,570,753
負債の部		
流動負債		
買掛金	5,691,824	7,527,123
短期借入金	3,818,115	5,132,086
1年内返済予定の長期借入金	3,333,751	3,579,408
1年内償還予定の社債	70,000	60,000
未払法人税等	164,031	241,121
賞与引当金	90,998	97,336
その他	345,200	370,525
流動負債合計	13,513,921	17,007,601
固定負債		
社債	120,000	90,000
長期借入金	4,147,681	4,647,896
退職給付に係る負債	20,147	20,039
その他	747	1,895
固定負債合計	4,288,576	4,759,830
負債合計	17,802,498	21,767,432
純資産の部		
株主資本		
資本金	993,136	993,136
資本剰余金	673,636	676,427
利益剰余金	2,178,947	2,537,967
自己株式	△465,140	△419,530
株主資本合計	3,380,580	3,788,000
その他の包括利益累計額		
為替換算調整勘定	15,041	7,266
その他の包括利益累計額合計	15,041	7,266
非支配株主持分	7,931	8,053
純資産合計	3,403,553	3,803,320
負債純資産合計	21,206,051	25,570,753

(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書

(四半期連結損益計算書)

(第2四半期連結累計期間)

(単位：千円)

	前第2四半期連結累計期間 (自平成28年4月1日 至平成28年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自平成29年4月1日 至平成29年9月30日)
売上高	21,186,985	26,491,288
売上原価	20,391,717	24,518,816
売上総利益	795,268	1,972,471
販売費及び一般管理費	966,058	1,133,265
営業利益又は営業損失(△)	△170,790	839,206
営業外収益		
受取利息	2,313	1,918
仕入割引	9,380	2,597
為替差益	—	12,159
その他	5,317	6,640
営業外収益合計	17,010	23,316
営業外費用		
支払利息	63,678	85,309
債権売却損	15,946	20,094
支払手数料	17,189	20,600
為替差損	160,625	—
その他	1,449	244
営業外費用合計	258,888	126,247
経常利益又は経常損失(△)	△412,668	736,275
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期 純損失(△)	△412,668	736,275
法人税、住民税及び事業税	4,326	222,200
法人税等調整額	△145,527	10,773
法人税等合計	△141,201	232,973
四半期純利益又は四半期純損失(△)	△271,466	503,301
非支配株主に帰属する四半期純利益	783	785
親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主 に帰属する四半期純損失(△)	△272,250	502,515

(四半期連結包括利益計算書)

(第2四半期連結累計期間)

(単位：千円)

	前第2四半期連結累計期間 (自平成28年4月1日 至平成28年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自平成29年4月1日 至平成29年9月30日)
四半期純利益又は四半期純損失(△)	△271,466	503,301
その他の包括利益		
為替換算調整勘定	△53,514	△7,652
その他の包括利益合計	△53,514	△7,652
四半期包括利益	△324,981	495,648
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	△324,761	494,740
非支配株主に係る四半期包括利益	△220	908

(3) 四半期連結財務諸表に関する注記事項

(継続企業の前提に関する注記)

該当事項はありません。

(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)

該当事項はありません。

3. 品目別販売実績

品目別	前第2四半期連結累計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年9月30日)		当第2四半期連結累計期間 (自 平成29年4月1日 至 平成29年9月30日)		増減率 (%)
	金額(千円)	構成比(%)	金額(千円)	構成比(%)	
液晶	11,011,853	52.0	9,653,741	36.4	△12.3
半導体	6,434,974	30.4	8,781,698	33.2	36.5
電子機器	2,717,396	12.8	6,706,479	25.3	146.8
その他	1,022,761	4.8	1,349,368	5.1	31.9
合計	21,186,985	100.0	26,491,288	100.0	25.0

(注) 当連結グループの事業は、半導体及び電子部品の販売事業の単一事業であるため、品目別の販売実績を記載しております。